

---

# 2024年12月期 決算説明会

---

2025年2月14日（金）

 **メック株式会社**

証券CODE:4971

<https://www.mec-co.com/>

**1** 売上：18,234百万円（前期比 30.1%増）  
営業利益：4,562百万円（前期比 83.0%増）

**2** 為替の影響は前期比  
売上：624百万円増、営業利益：350百万円増

**3** 薬品売上：17,478百万円（前期比 27.0%増）  
出荷量：42,075ton（前期比 18.9%増）

**4** 主要製品売上は前期比  
CZ 31.0%増、EXE 22.5%増、SF 19.6%増、V-Bond 11.8%増

(単位：円)

	期初想定	2024Q4	2023Q4	2024Q3
N T D	4.48	4.72	4.52	4.72
R M B	19.66	21.04	19.81	20.95
H K D	17.73	19.41	17.96	19.28
T H B	4.01	4.31	4.04	4.24
E U R	150.22	163.79	152.27	163.86
U S D	138.87	151.44	140.55	150.62

- 海外現地法人は、基本的に現地通貨建てでの取引であり、連結会計で円換算する際に、円／現地通貨レートの影響を受ける。
  - いずれも、期中平均レートを採用。
  - 当社の主要外国通貨は、台湾ドル（NTD）、中国人民元（RMB）。
  - 各通貨に対して想定レートから0.1円変動する場合の影響額は次のとおり。  
 NTD：（売上）70百万円（営業利益）51百万円  
 RMB：（売上）27百万円（営業利益）16百万円
- \*いずれも、当期累計実績

# 2024年12月期 業績概要



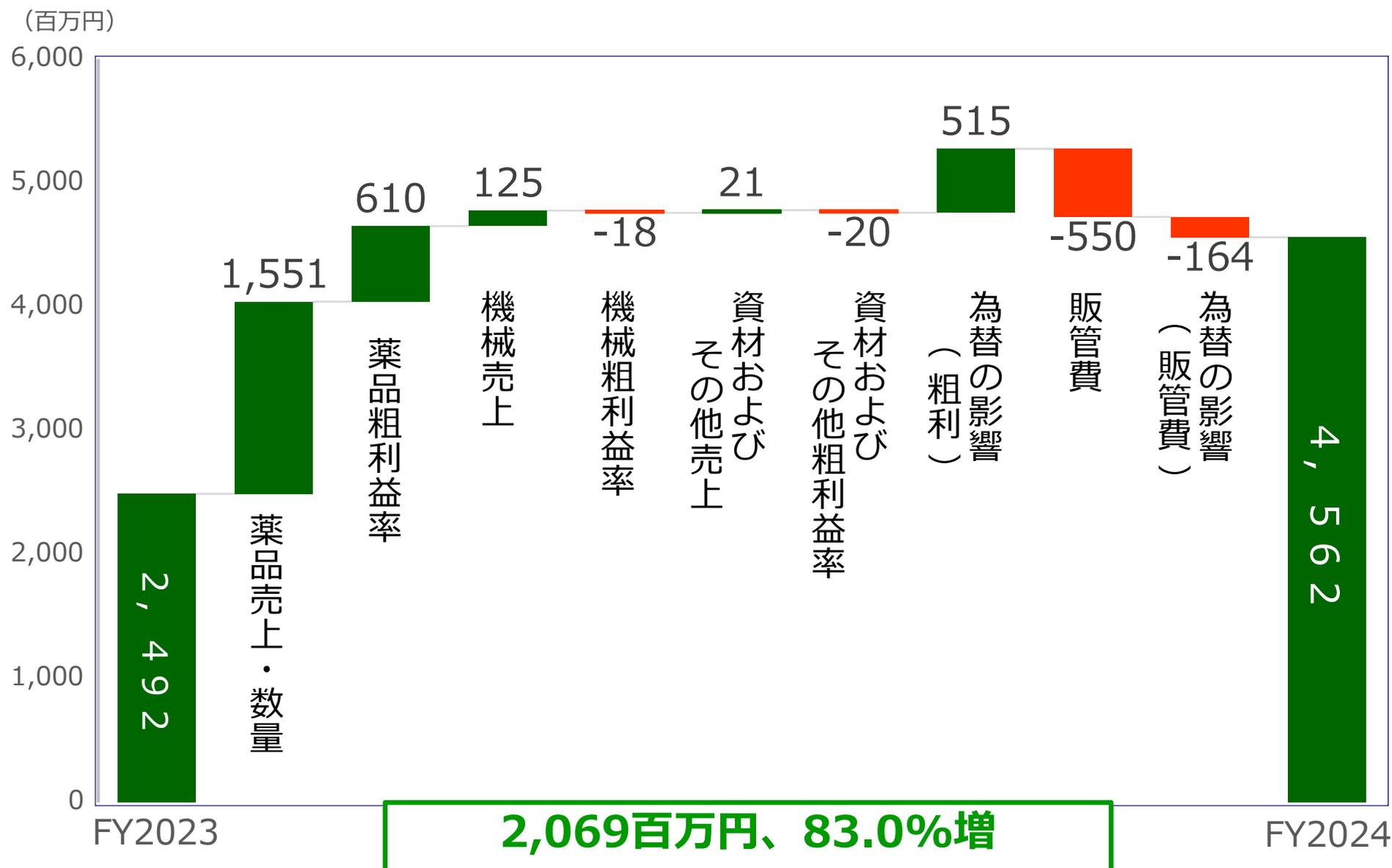
(単位：百万円)

項目	FY2023 (実績)	FY2024		
		(実績)	前期比	
売上高	14,020	18,234	4,214	30.1%
薬品売上高	13,764	17,478	3,713	27.0%
売上総利益	8,316	11,101	2,784	33.5%
売上総利益率	59.3%	60.9%	1.6ppt	-
販売費及び一般管理費	5,824	6,539	715	12.3%
売上高比率	41.5%	35.9%	△5.6ppt	-
営業利益	2,492	4,562	2,069	83.0%
営業利益率	17.8%	25.0%	7.2ppt	-
経常利益	2,683	4,682	1,999	74.5%
経常利益率	19.1%	25.7%	6.6ppt	-
税引前当期利益	3,219	4,669	1,450	-
当期純利益	2,304	2,291	△13	△0.6%
EBITDA	3,993	5,487	1,494	37.4%
1株当たり当期利益 (円)	122.29	122.38	-	-
1株当たり配当金 (円)	45.00	45.00	-	-
ROE	9.6%	8.9%	△0.7ppt	-

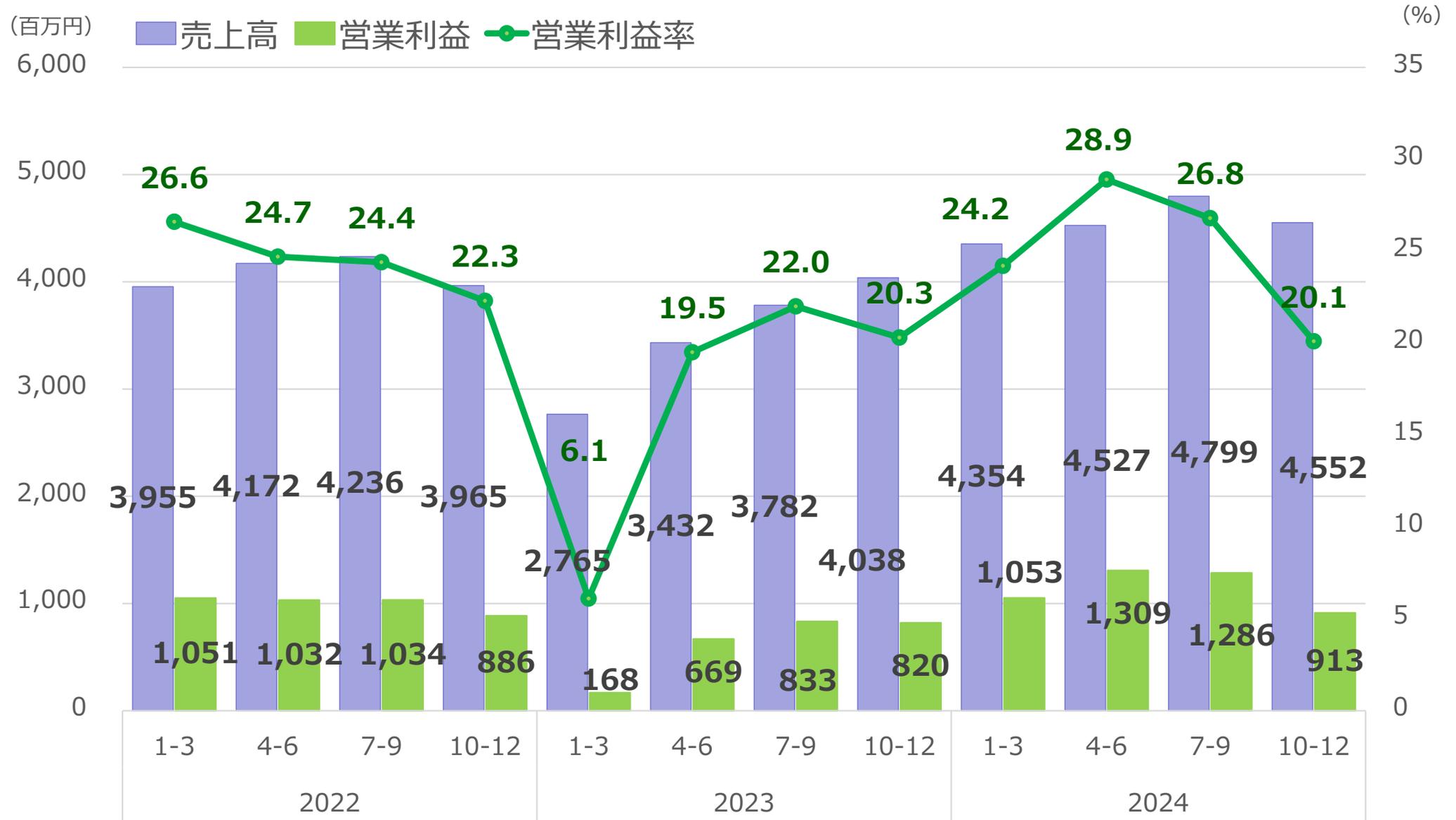
# 連結売上高前期比分析



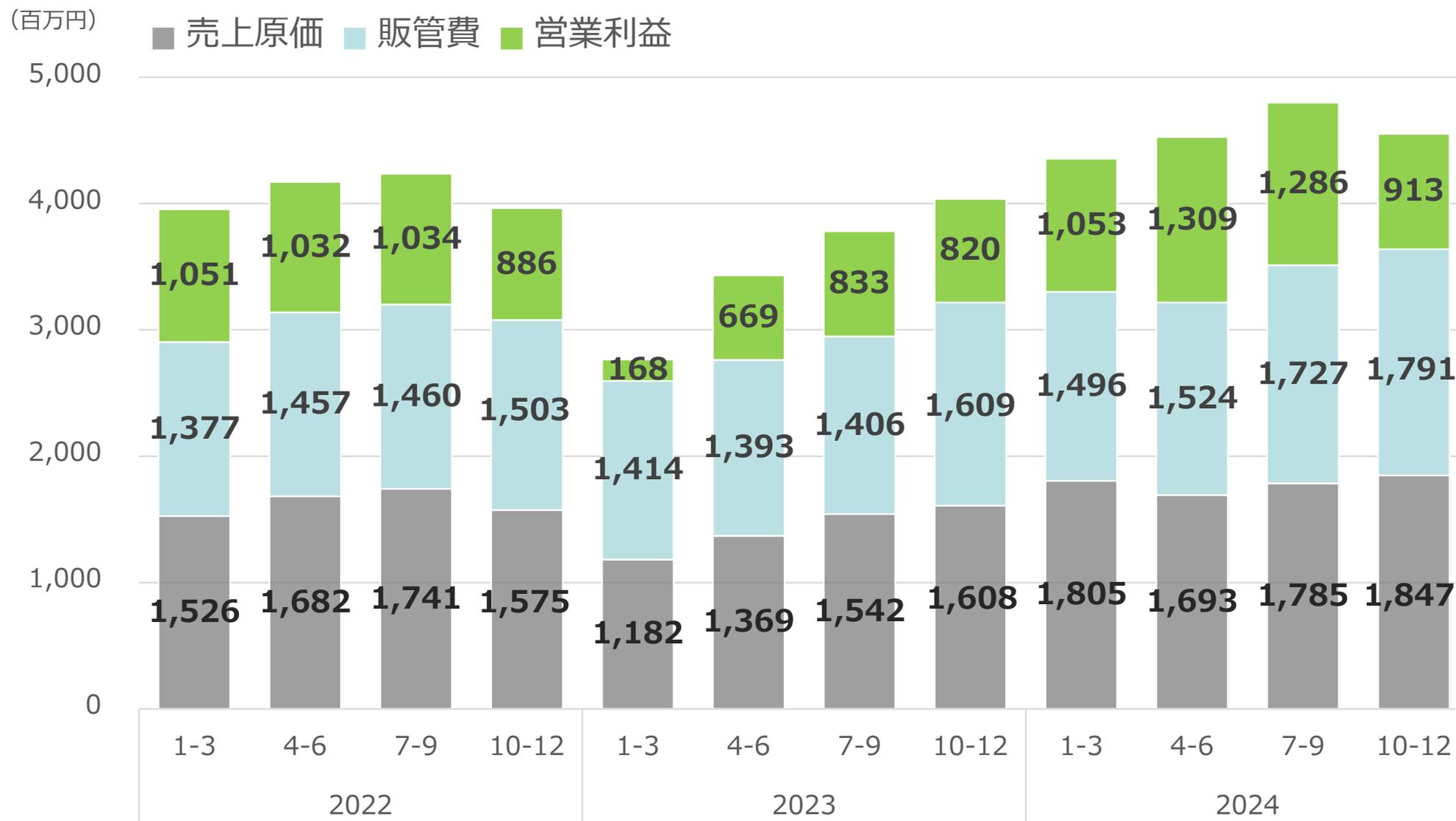
# 連結営業利益前期比分析



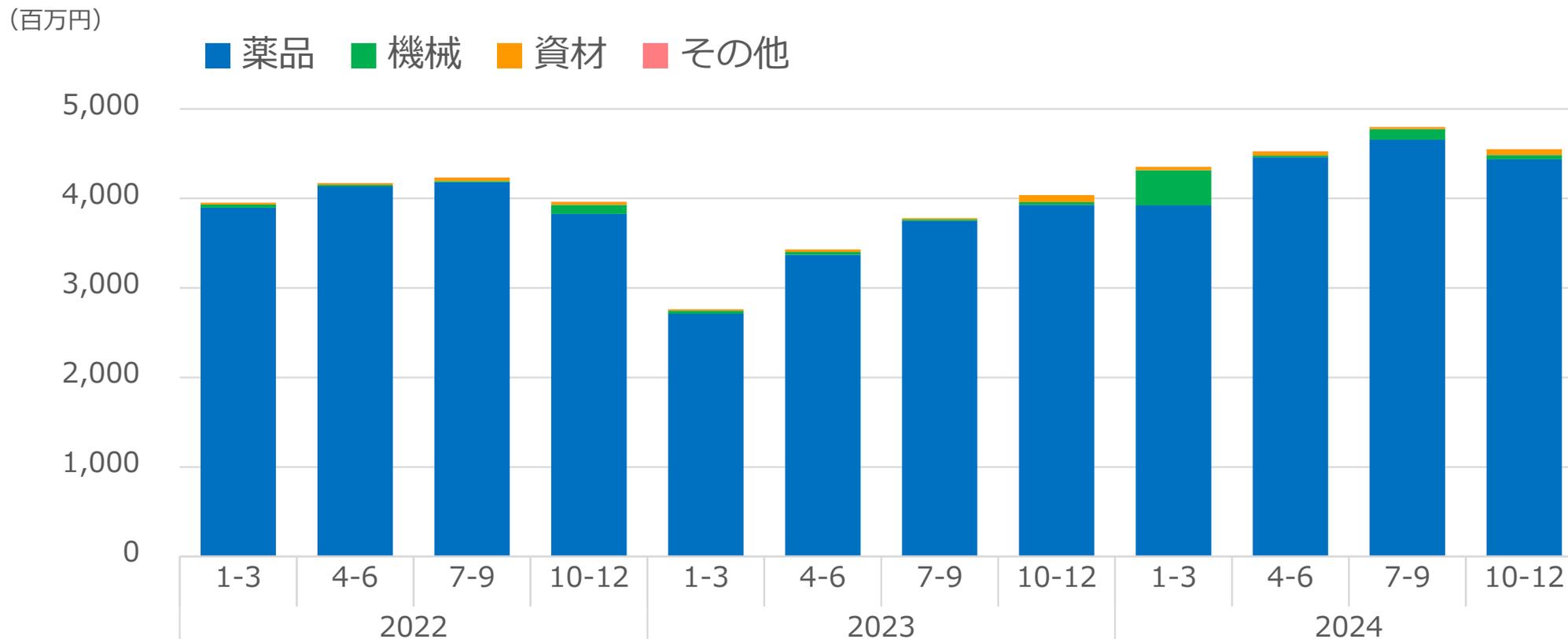
# 連結売上高と営業利益/営業利益率



# 連結損益構造

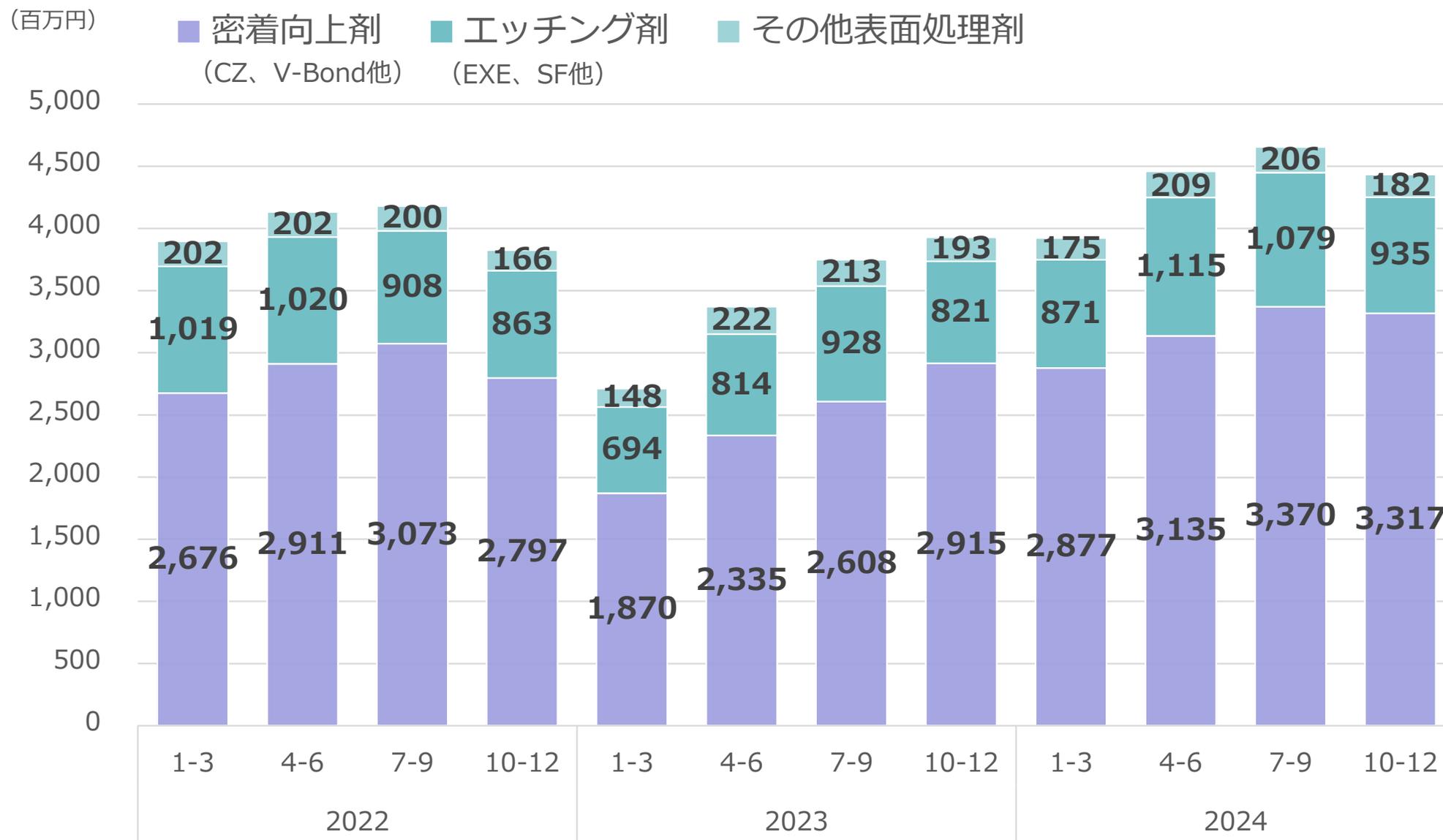


# 連結品種別売上高

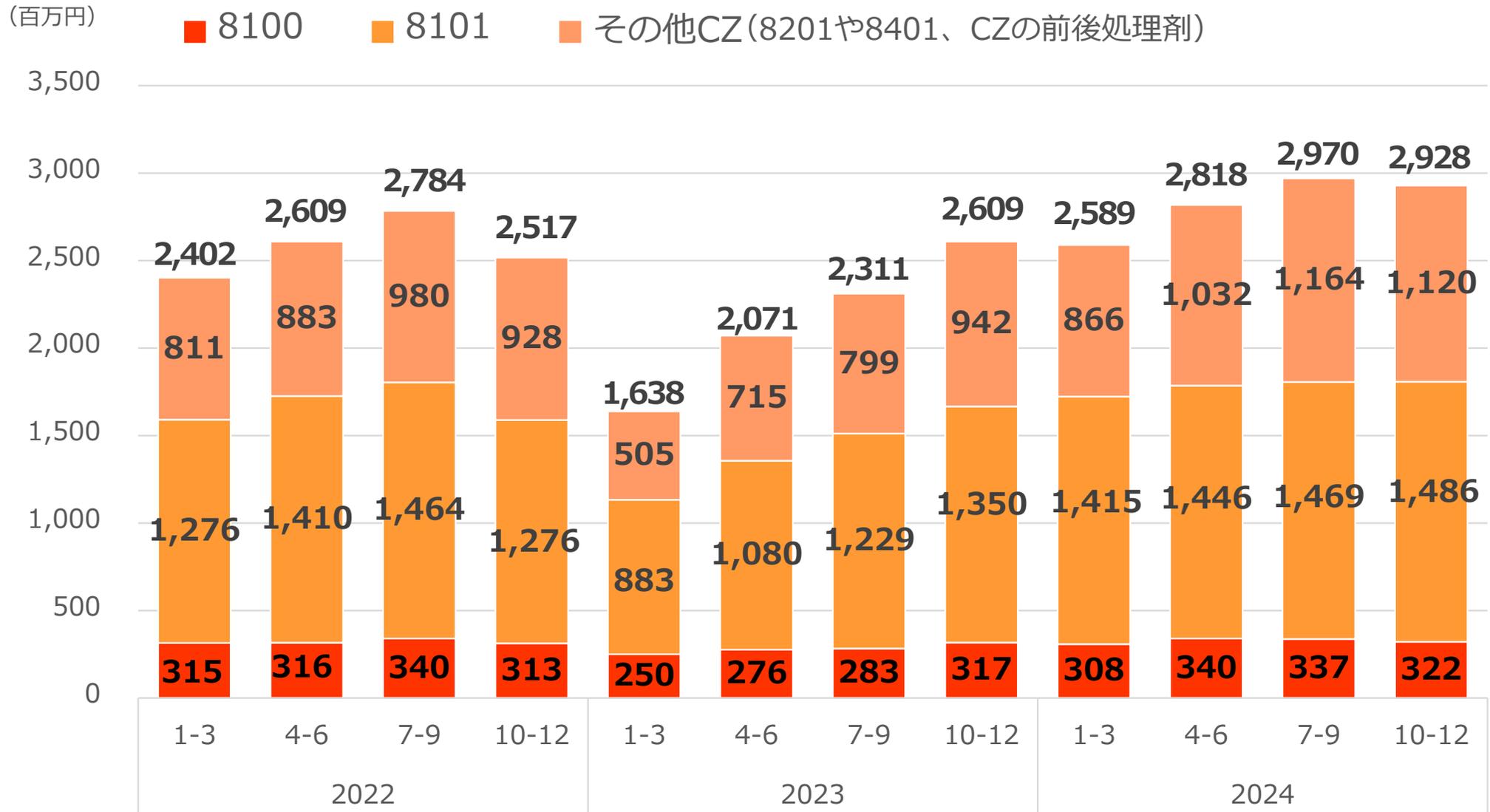


■ その他	1	1	1	3	1	1	0	0	1	3	1	1
■ 資材	18	19	38	31	16	27	15	80	37	44	22	64
■ 機械	36	17	13	102	34	31	17	28	391	19	118	49
■ 薬品	3,898	4,134	4,181	3,827	2,712	3,372	3,749	3,929	3,924	4,460	4,657	4,436

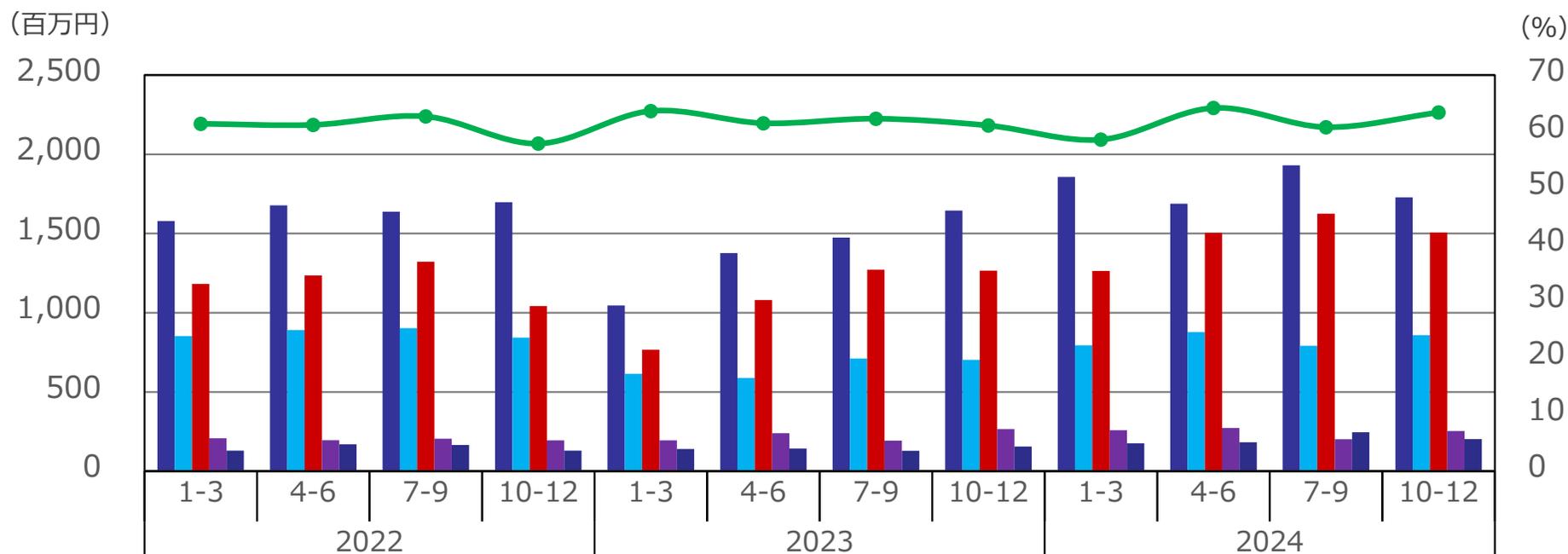
# 連結薬品別売上高



# CZシリーズ売上高



# 地域セグメント別売上高

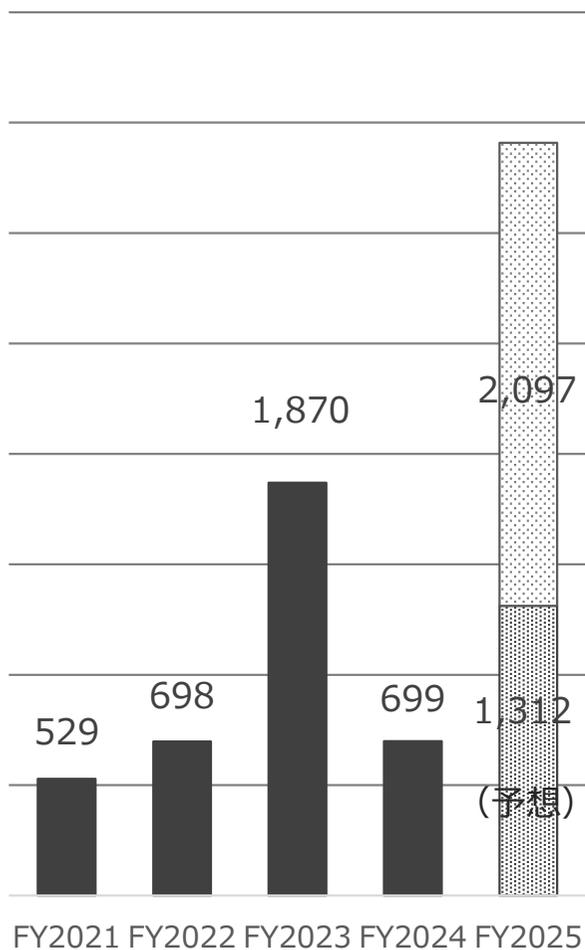


■ 日本	1,579	1,678	1,638	1,698	1,046	1,376	1,474	1,645	1,857	1,688	1,931	1,728
■ 台湾	853	891	903	844	615	589	711	703	795	878	792	859
■ 中国	1,182	1,236	1,322	1,043	767	1,081	1,272	1,266	1,265	1,504	1,625	1,506
■ 欧州	208	196	205	195	195	240	193	266	259	273	202	254
■ タイ	130	170	165	130	140	143	129	156	176	183	246	203
● 海外売上高比率	61.4	61.2	62.7	57.9	63.7	61.5	62.3	61.1	58.6	64.2	60.8	63.4

- ・ 当社薬品海外使用分の国内代理店販売を海外売上高に加算した場合の比率は78.5% (前年同一期間は79.7%)。

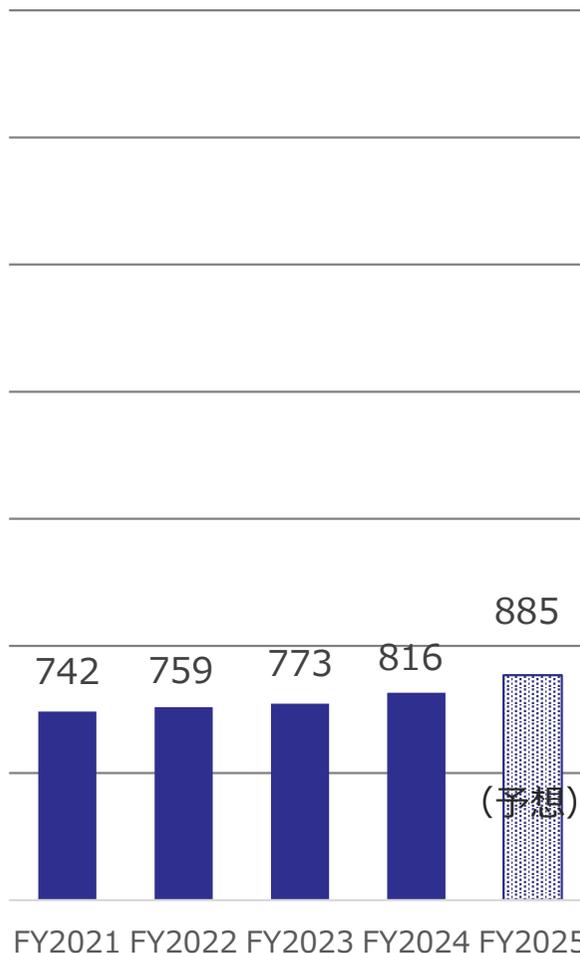
# 設備投資額と減価償却費、研究開発費

設備投資額 (百万円)



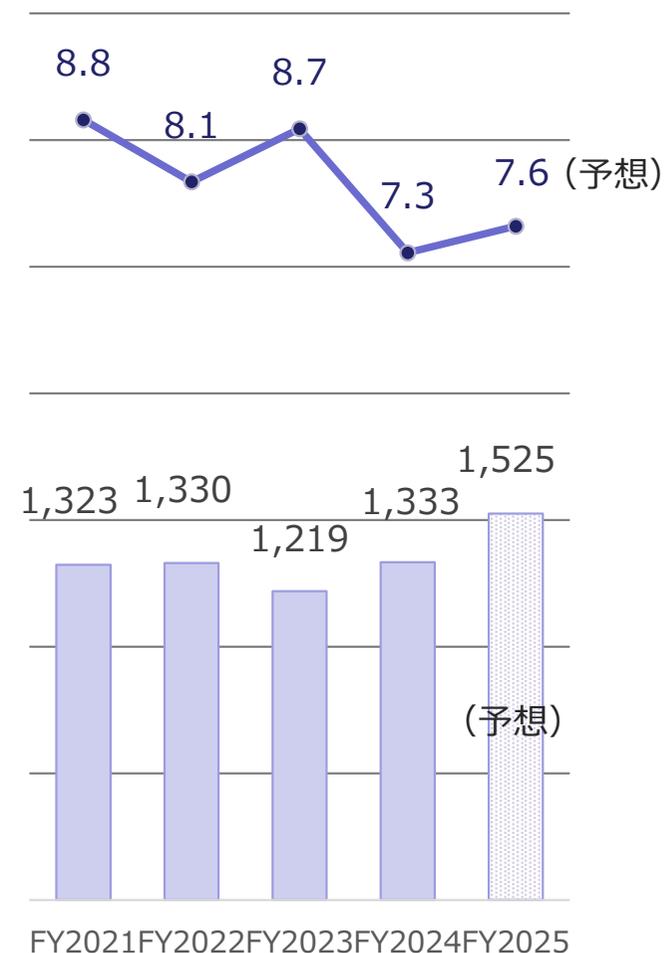
■ 北九州工場に係る設備投資額

減価償却費 (百万円)



北九州工場に係る減価償却費は稼働後、2～2.5億円/年程度となる見込み

研究開発費と売上高研究開発費比率



# 当社の技術と今後の見通し

# 主要薬品用途と最終製品例

主要薬品	特徴	最終製品例
超粗化系密着向上剤 「CZシリーズ」	銅と樹脂との密着性を高める銅表面処理剤。 主にPKG基板向けの密着向上剤で、高密度PCBにも使用される。	生成AI関連、5G/6G関連・データセンター等のインフラ、パソコン・スマートフォン・タブレットPC等の高機能デバイス等
多層電子基板向け密着向上剤 「V-Bondシリーズ」	銅と樹脂との密着性を高める銅表面処理剤。 多層基板向けの密着向上剤で、PKG基板には使用されない。	クルマ、スマートフォン、衛星通信等
異方性エッチング 「EXEシリーズ」	サブトラで微細配線形成ができる。 主にCOF基板向けのエッチング剤として使用される。	テレビ・パソコンのモニター等
選択エッチング銅除去剤 「SFシリーズ」	銅への選択性を持ったエッチング剤。	タブレットPC等

## 事業環境

- ・短期的には、回復基調にある半導体市況の影響を見込む。
- ・中長期的には、デジタル革命の進展に伴い技術革新が進み、IoTやAI、5G/6G、クルマの電動化・自動化・コネクテッド化やDX・GXの進展等、技術の広がりを背景に技術革新が進み、当社関連市場の拡大が進む。
- ・特に高まる半導体需要によるPKG基板の増加、超高密度化や超高周波化により関連する「CZシリーズ」、「化学密着向上剤」需要の伸びを見込む。

## 主要製品

- CZ : 短期的には半導体市況回復の影響を受ける。  
中長期的にはPKG基板の増加、大型・高多層化等により需要拡大。
- V-Bond : 短期的にはクルマ、スマートフォンは回復基調。
- EXE : 短期的にはディスプレイの在庫調整が進み回復基調。  
継続性は不透明。
- SF : タブレットPC需要の影響を受ける。

# PKG基板の超高密度化、超高周波化

超高密度  
超高周波

最先端品 化学密着向上剤 APシリーズ

Flat Organic Adhesion Promotor

先端品

CZ-8401  
×化学密着向上剤 APシリーズ

Super finely roughen + Organic Adhesion Promotor

CZ-8201



Very finely roughened

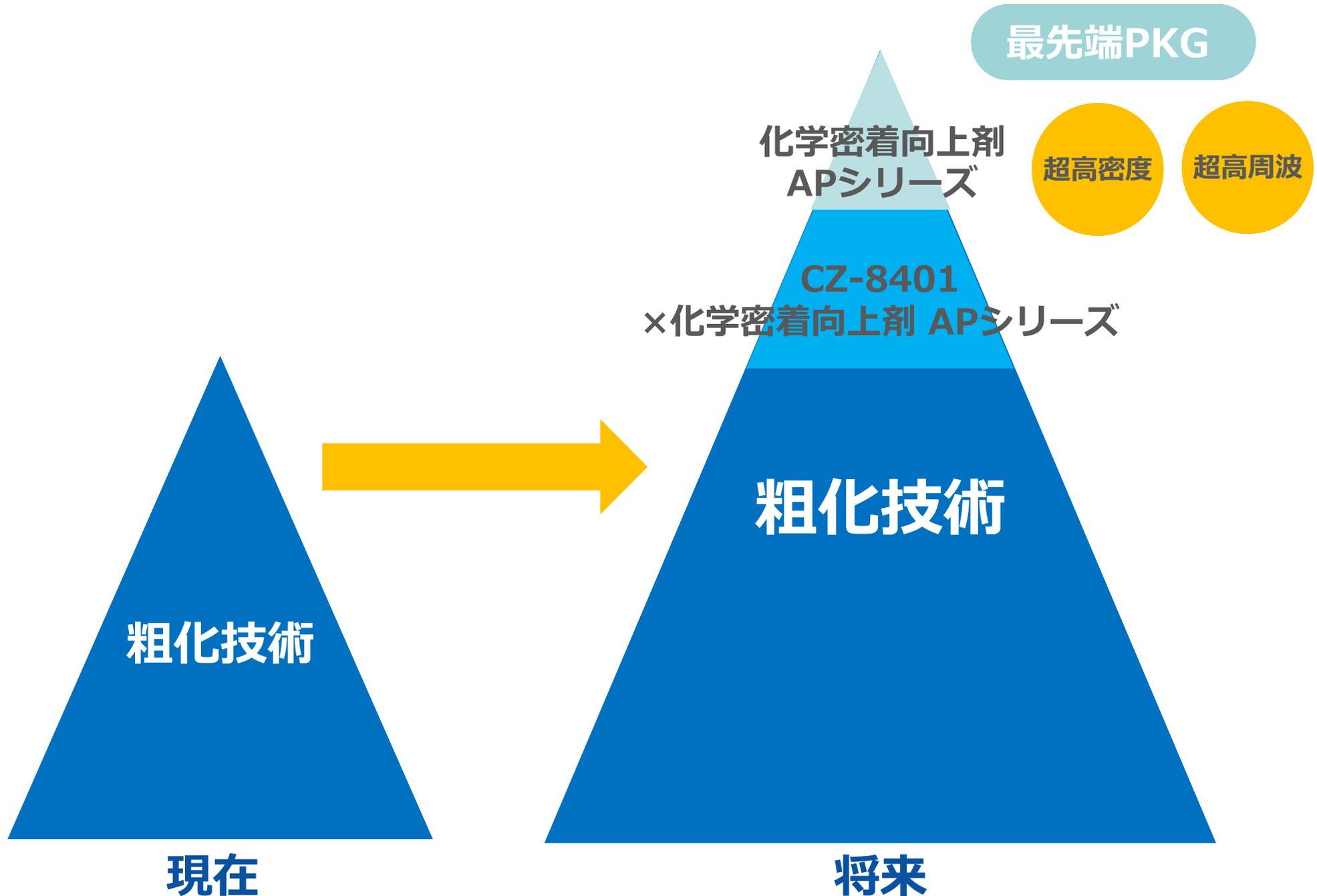
汎用品

CZ-8101

CZ-8100

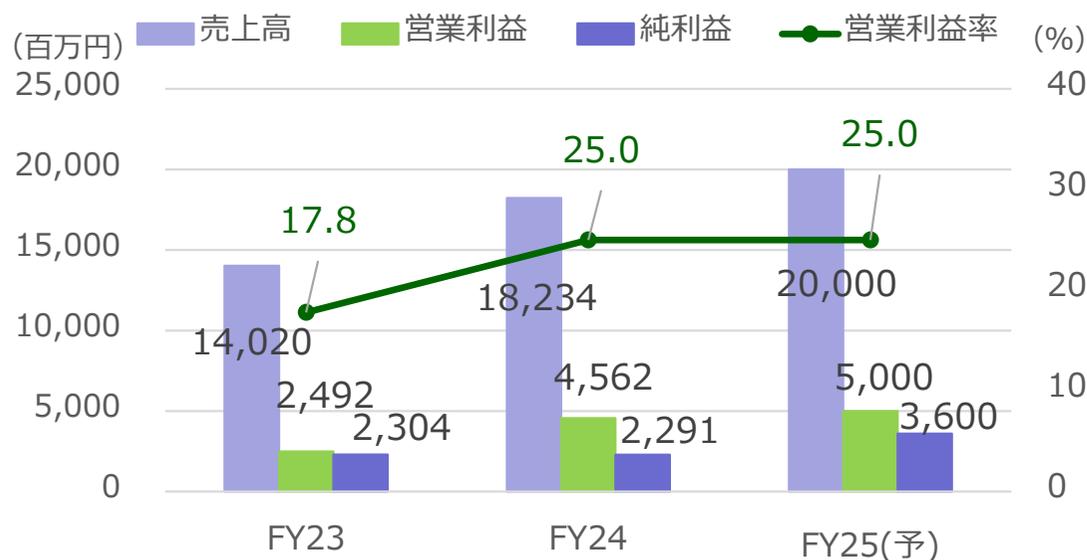


Finely roughened



# 2025年12月期 連結業績予想

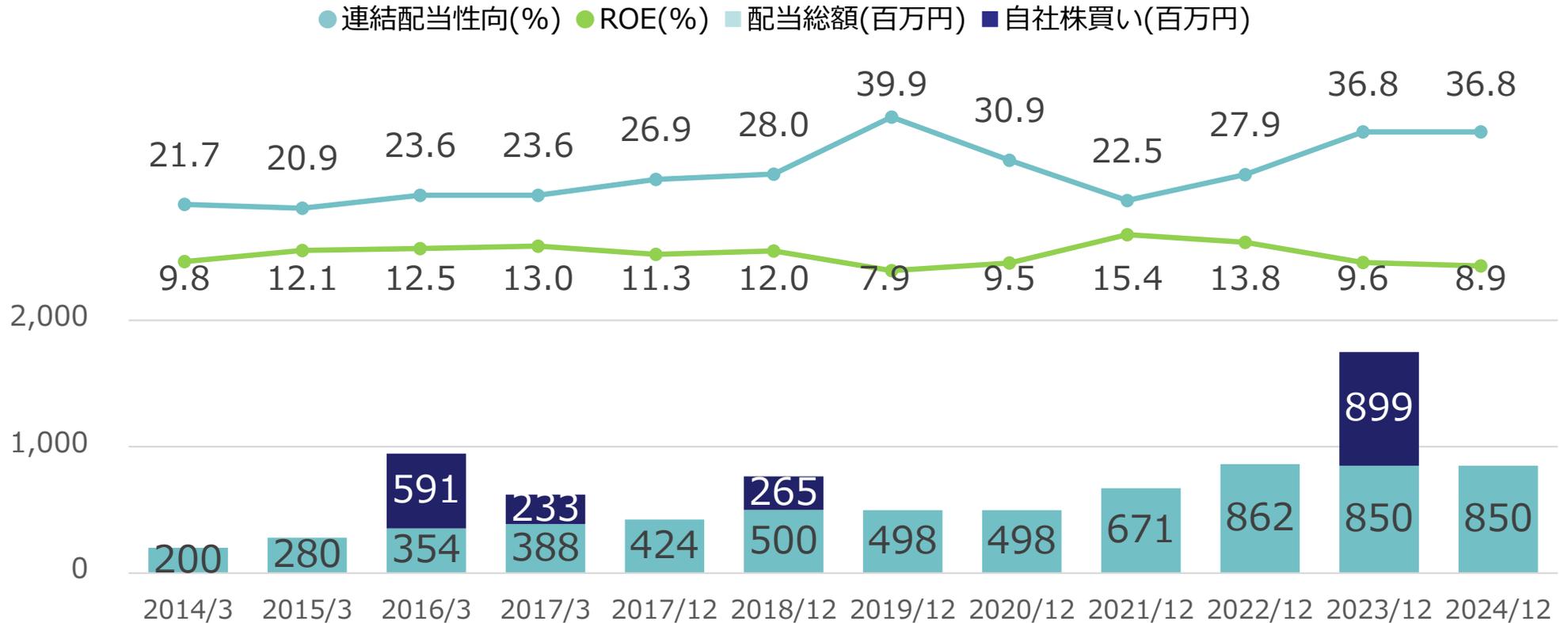
	FY2024		FY2025					
	Full-year		1 H			Full-year		
	百万円	利益率 (%)	百万円	利益率 (%)	増減率	百万円	利益率 (%)	増減率
売上高	18,234	-	9,600	-	8.1%	20,000	-	9.7%
営業利益	4,562	25.0	2,250	23.4	△4.8%	5,000	25.0	9.6%
経常利益	4,682	25.7	2,300	24.0	△12.9%	5,100	25.5	8.9%
純利益	2,291	12.6	1,450	15.1	△23.3%	3,600	18.0	57.1%
1株当たり純利益 (円)	122.38	-	77.44	-	-	192.26	-	-



## 為替レート

	FY2024	FY2025
N T D	4.72	4.76
R M B	21.04	21.08
H K D	19.41	19.48
T H B	4.31	4.22
E U R	163.79	164.84
U S D	151.44	152.33

# 配当金総額と連結配当性向、ROEの推移



## + 配当性向

中期目標 連結配当性向 30%

## + ROE

目標 10%以上

## + 2025年12月期 配当予想

55.0円 (中間 25.0円、期末 30.0円、連結配当性向 28.6%)

\* 2024年12月期実績 : 45円 (中間20.0円、期末25.0円)

## Environment

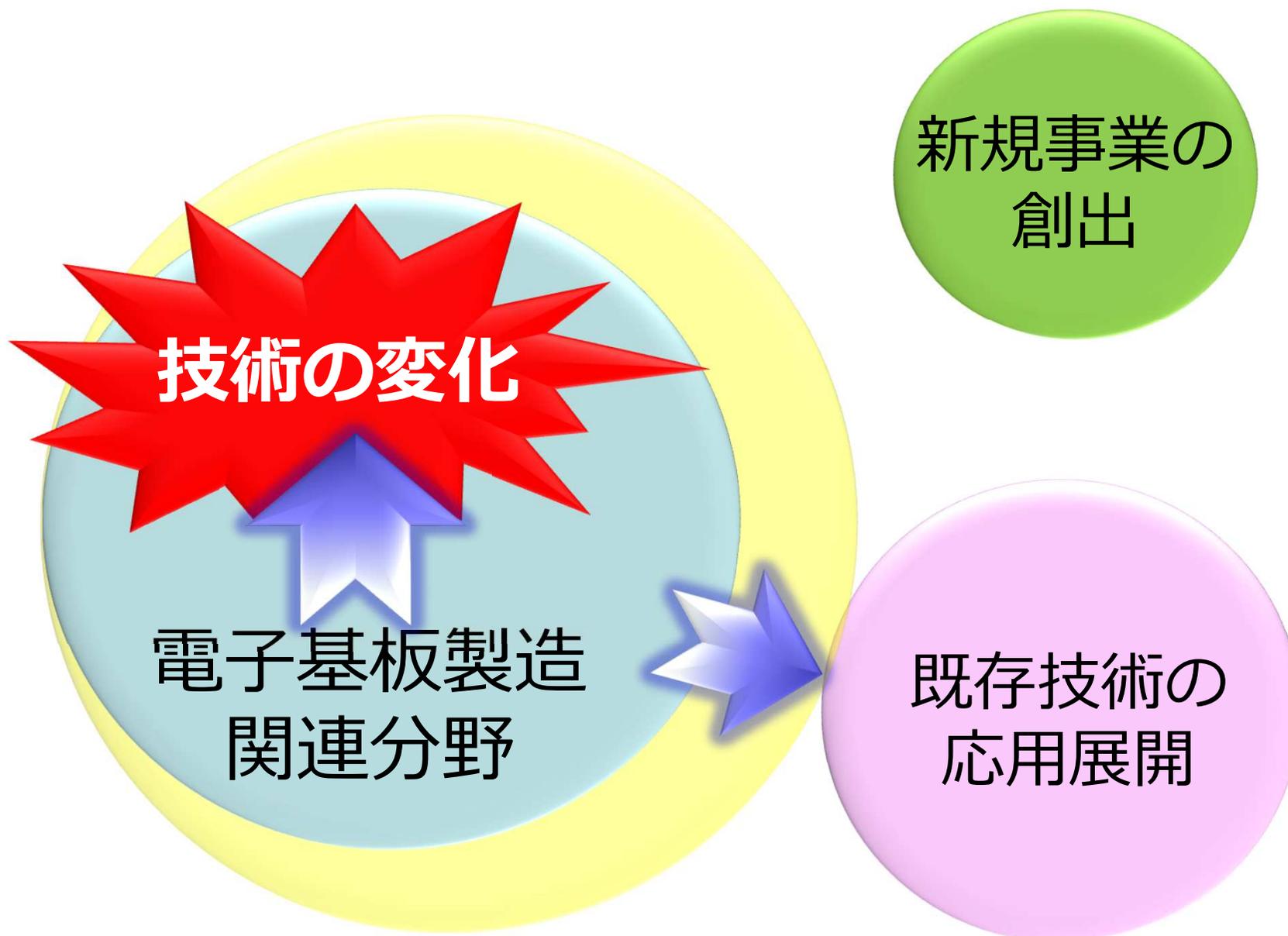
- 環境負荷低減製品の開発
- 適正な化学物質管理
- 資源循環の推進
- 気候関連問題への対応

## Social

- 人的資本戦略
- 多様な人財の活用（女性活躍、WLB、男性の育休取得推進等）
- 産業発展への貢献（高速通信整備、自動運転、AI、DX、GX等）

## Governance

- 経営基盤の強化（CG体制、リスクマネジメント、コンプライアンスの徹底等）



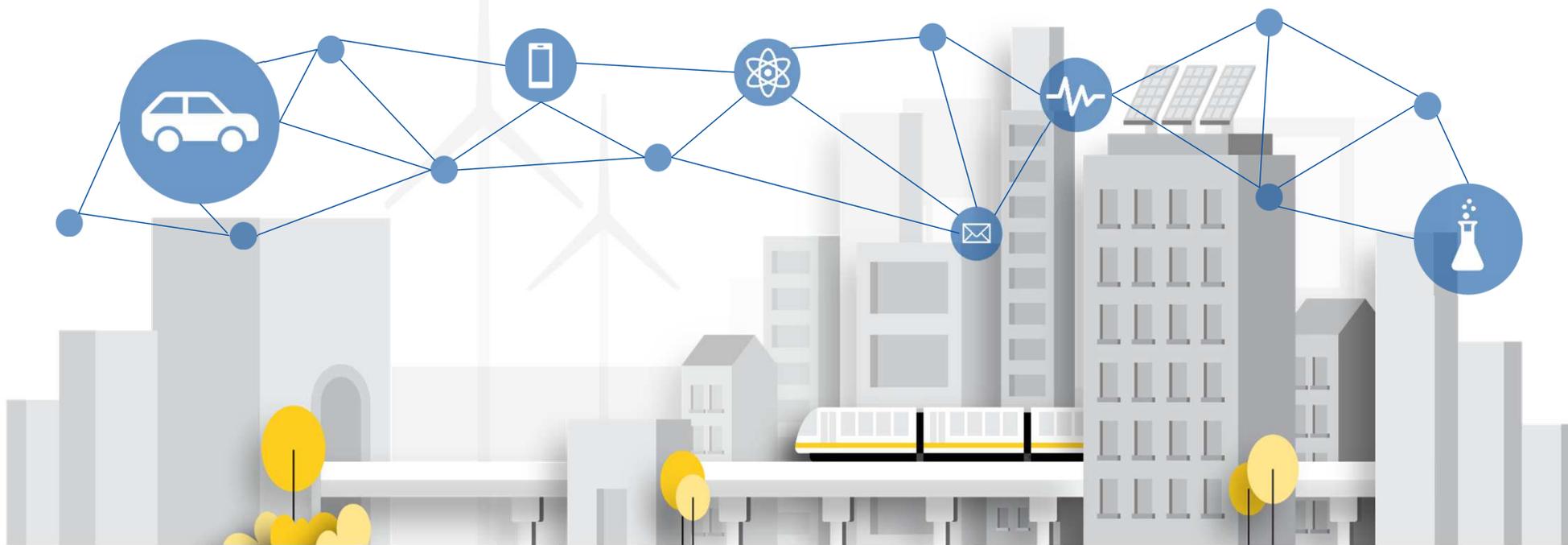
# 2030年ビジョン

## Phase 2

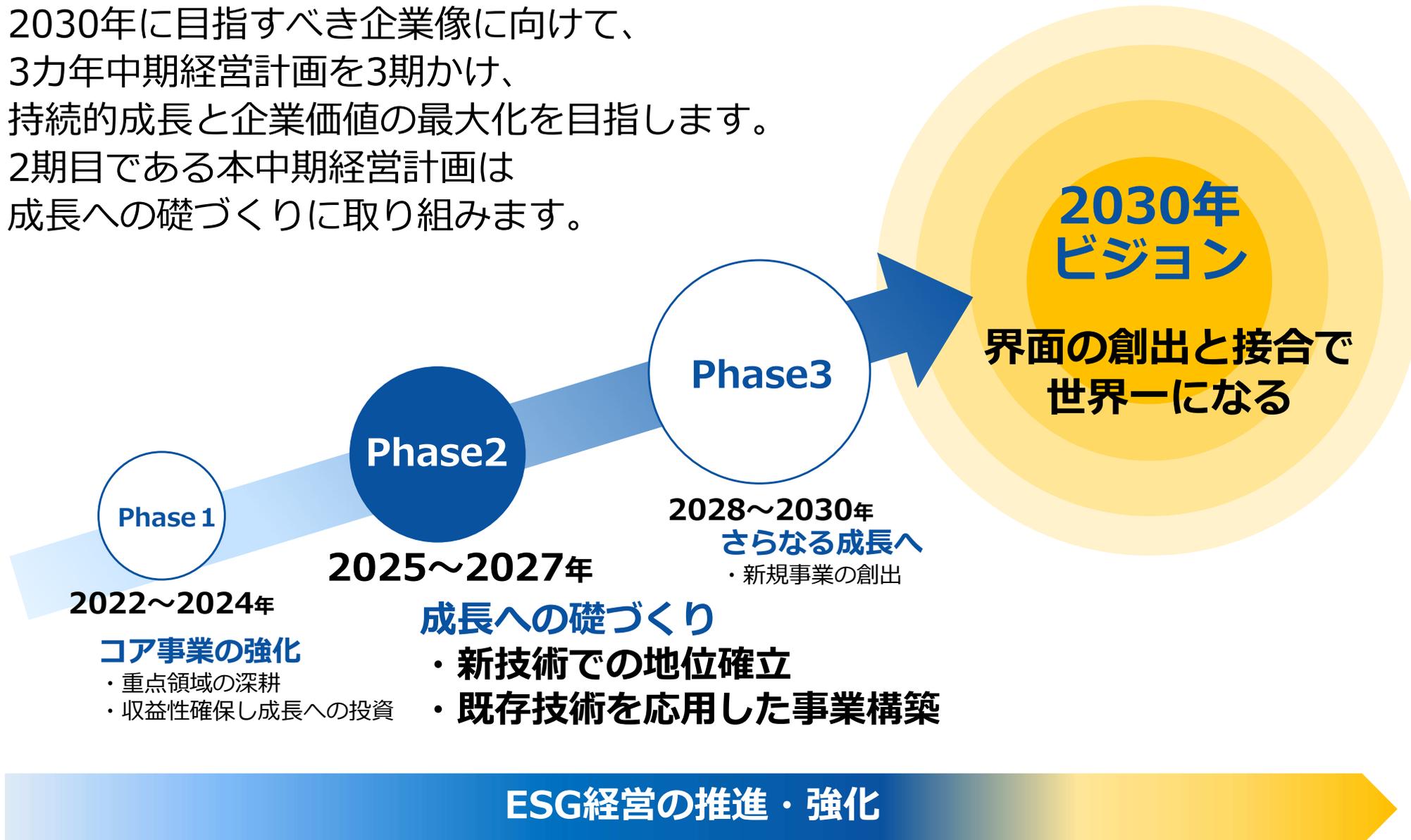
### 中期経営計画

(2025-2027)

2025年2月14日



2030年に目指すべき企業像に向けて、  
3カ年中期経営計画を3期かけ、  
持続的成長と企業価値の最大化を目指します。  
2期目である本中期経営計画は  
成長への礎づくりに取り組みます。



# Phase1（2022年～2024年）実績推移



2019年末に発生したコロナウイルス感染症はエレクトロニクス業界にも大きく影響を及ぼしました。2021年度は特需により売上が大きく増加し、一方、2023年度はその振り戻しを受け売上が大きく減少、各利益も悪化した結果、連結営業利益率およびROEともに目標を下回りました。2024年度においては、売上および営業利益は過去最高となったものの、2030年に目指すべき企業像に向け、事業の合理性および経営効率を勘案し、販売活動の縮小が続く連結子会社であるMEC（HONG KONG）LTD.の解散および清算を決定し、その子会社であるMEC FINE CHEMICAL（ZHUHAI）LTD.の当社完全子会社化を行いました。これらグループ再編に伴う日中の税金計上により法人税等が増加し、当期純利益が減少しました。さらに、為替が円安に振れたこと等による包括利益累計額増加も影響し、ROEは目標を下回る結果となりました。設備投資については、一部がPhase2への後ろ倒しとなりました。

	2021	2022	2023	2024	2024年目標
連結営業利益率	26.2%	24.5%	17.8%	25.0%	20%以上
ROE	15.4%	13.8%	9.6%	8.9%	10%以上
研究開発への投資	8.8%	8.1%	8.7%	7.3%	連結売上高 約10%
設備投資		6.9億円	18.7億円	6.9億円	累計50億円
（累計）	—	32.6億円			
連結配当性向	22.5%	27.9%	36.8%	36.8%	連結配当性向30%
（1株当たり年間配当金額）	(35円)	(45円)	(45円)	(45円)	
（自己株式取得）	—	—	実施	—	状況に応じて機動的に実施

## 拡大する市場

-  **次世代通信ネットワーク**  
(5G/6G、光通信、衛星通信)
-  **IoT**  
(あらゆるモノがネット接続)
-  **AIの多様化**  
(DX、エッジAI、医療等)
-  **次世代モビリティ**  
(自動運転車、運転アシストシステム等)

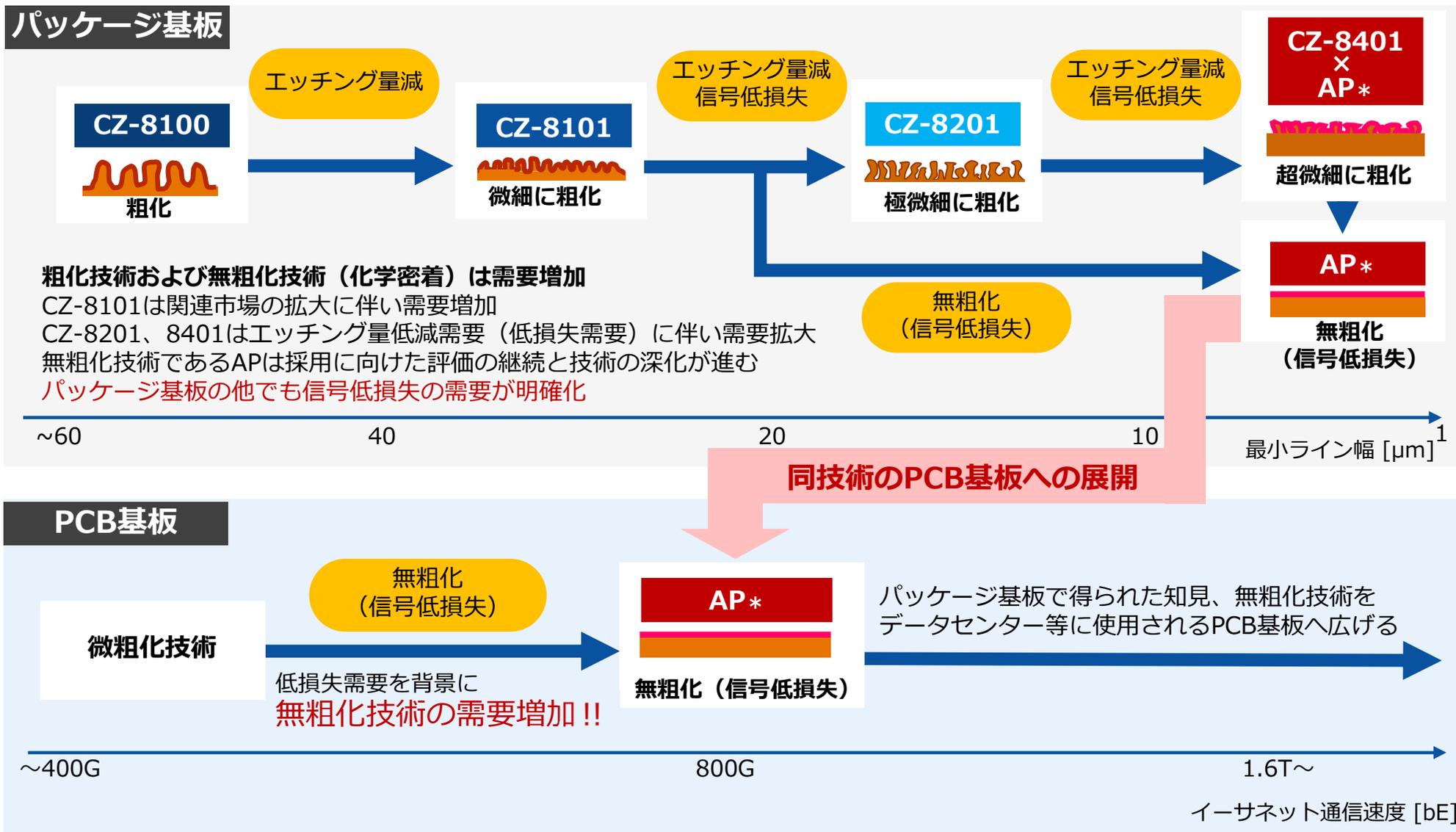
コア事業の**市場拡大**  
(半導体、電子基板市場)



## 求められる技術

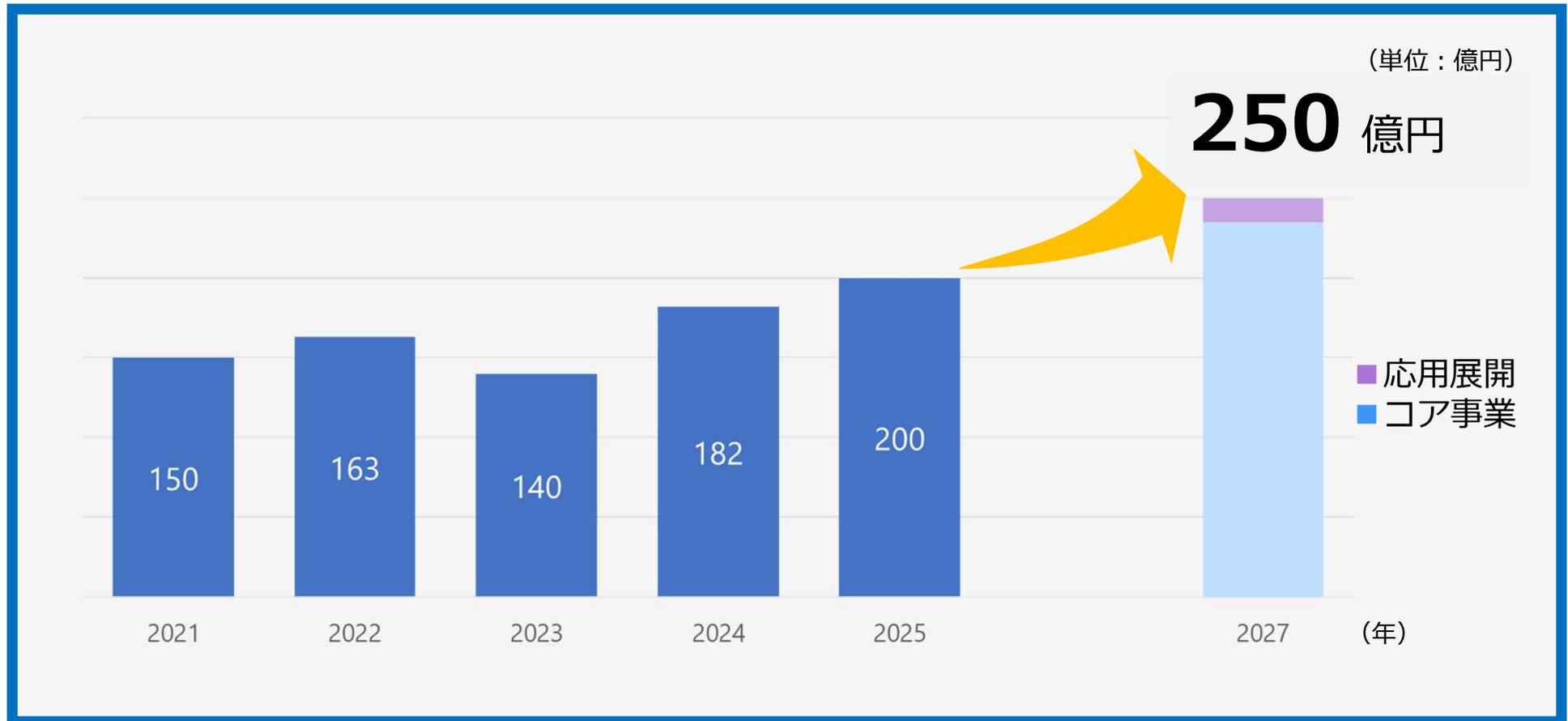
-  **高速情報処理**
-  **低電力消費**
-  **小型化**
-  **信号低損失**
-  **高集積二一ズ拡大**

超微粗化、無粗化技術による  
**密着向上剤の需要拡大**  
(信号高速化、高密度化)



\* AP : Adhesion Promotor 無粗化技術による化学密着、微粗化に対する化学密着補強

コア事業での優位性を維持しつつ、  
新技術の領域においてデファクトスタンダードを獲得します。  
また、既存技術の応用展開にも取り組むことにより、2027年に250億円の  
売上獲得を目指します。



## 定量目標

連結売上高

2027年

**250**億円

コア事業 235億円  
応用展開 15億円

連結営業利益率

**20%**以上

ROE

**10%**以上

## 定性目標

### 既存市場における収益性維持・強化

- 顧客との関係性強化
- 超微粗化系密着向上処理のシェア維持
- 無粗化技術（化学密着）領域におけるソリューション確立
- 環境配慮薬品への取り組み

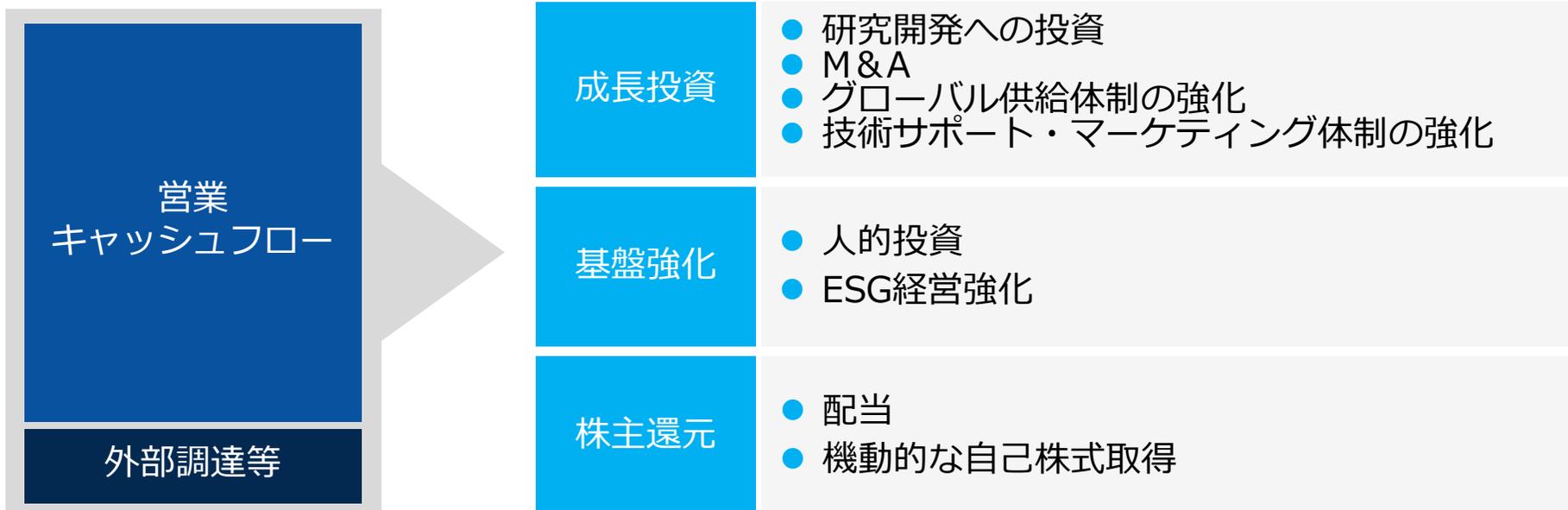
### 既存技術の応用展開分野における事業構築

### 新規事業の創出

### グローバル安定供給体制の確立

### ESG経営の推進・強化

## キャッシュ・アロケーション 基本方針



※各項目の大きさはその額の大きさを示すものではありません。

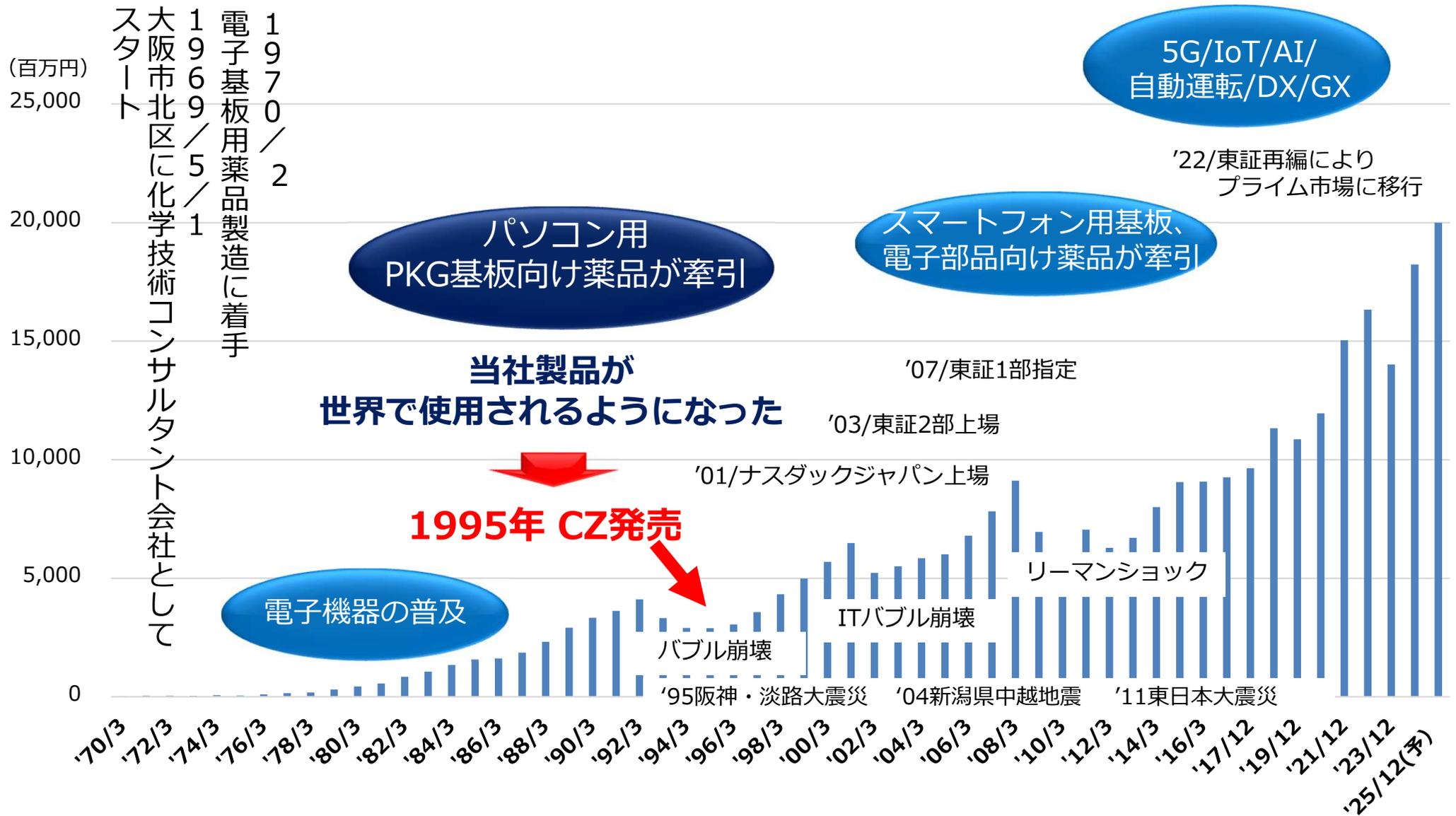
<b>研究開発に関する投資</b>  毎年 連結売上高の  <b>約10%</b>	<b>設備投資</b>  3力年累計  <b>約80億円</b>	<b>株主還元</b>  1株当たり年間配当金の 維持・成長  連結配当性向： <b>30%</b> 目標  自己株式取得は 状況に応じ機動的に実施
--	--	--

# 參考資料

(2024年12月31日現在)

社名	メック株式会社 MEC COMPANY LTD.
本社所在地	兵庫県尼崎市杭瀬南新町3丁目4番1号
設立年月日	1969（昭和44）年5月1日
主な業務内容	電子基板・部品製造用薬品の開発・製造販売 及び 機械装置、各種資材の販売
代表者	代表取締役社長 前田 和夫
資本金	5億9,414万2,400円
連結売上高	182億34百万円
上場市場	東証プライム市場（4971／化学セクター）
従業員数	連結480名、単体277名

# 創業からの売上推移





研究所から  
工場へ

テーマ決定 ⇒ ビーカー実験 ⇒ スケールアップ実験 ⇒ 応用ライン検証



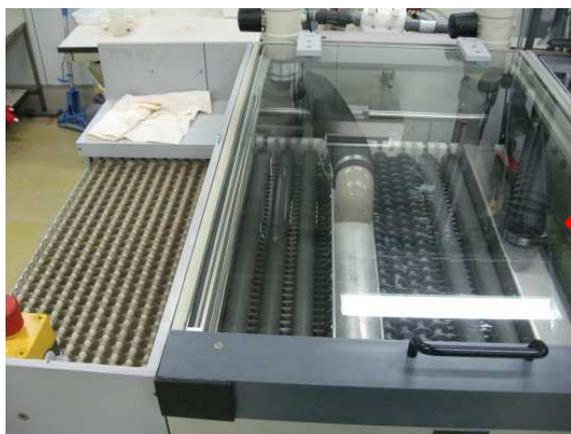
お客様へ



製造 ⇒ 品質検査 ⇒ 充填

# 当社製品の使用工程例

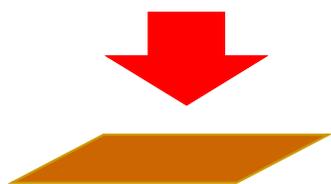
≪乾燥処理≫



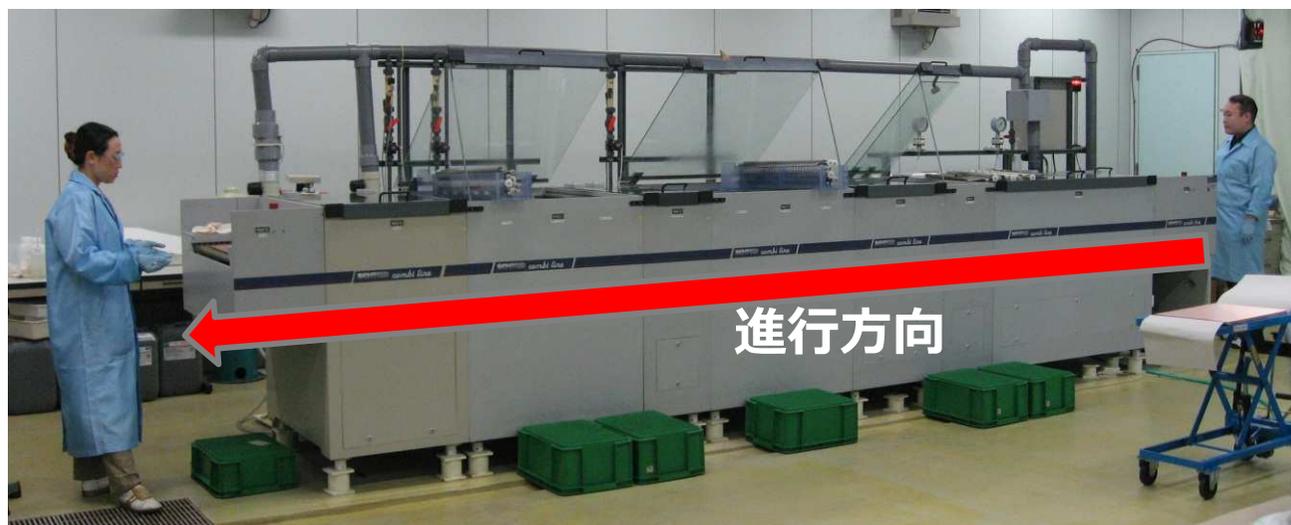
≪水洗処理≫



≪薬液処理≫



基板受取

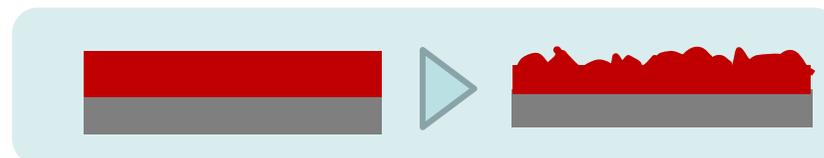


基板投入

## 界面価値創造

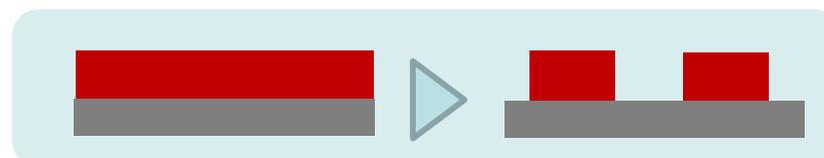
- **表面を粗化し、機械的に密着性を向上**

CZ、V-Bond



- **配線を形成する**

EXE

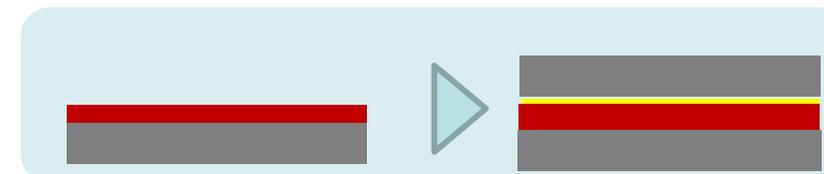


- **選択エッチング**

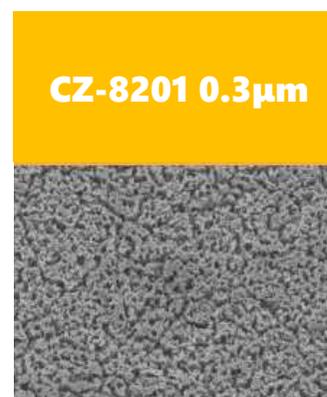
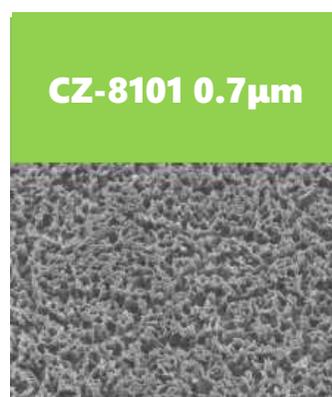
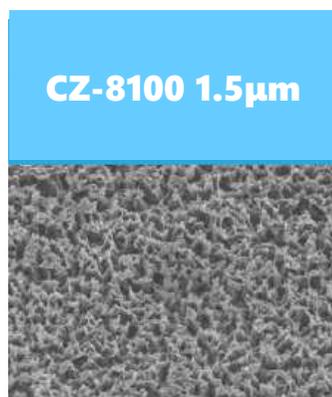
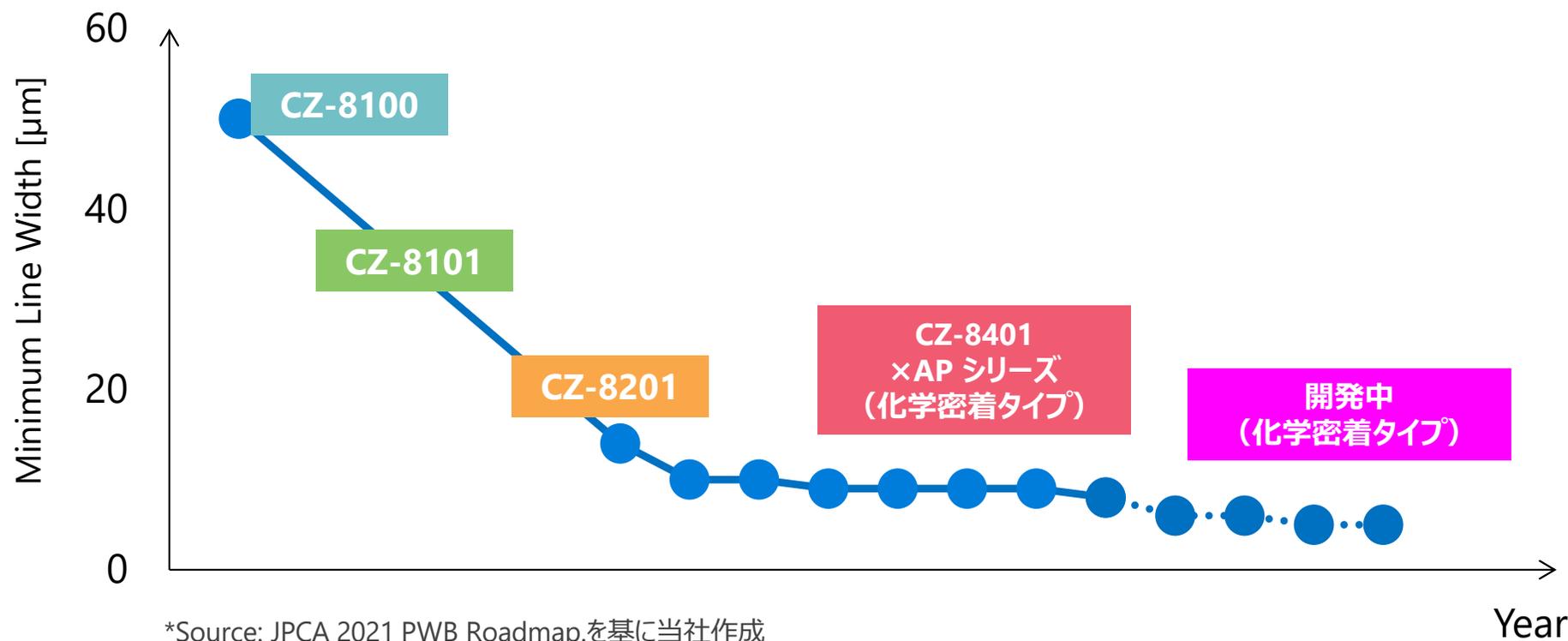
SF



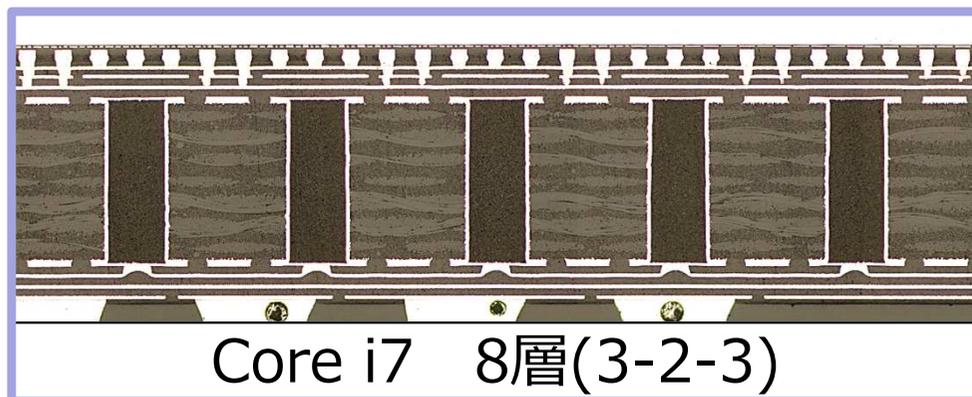
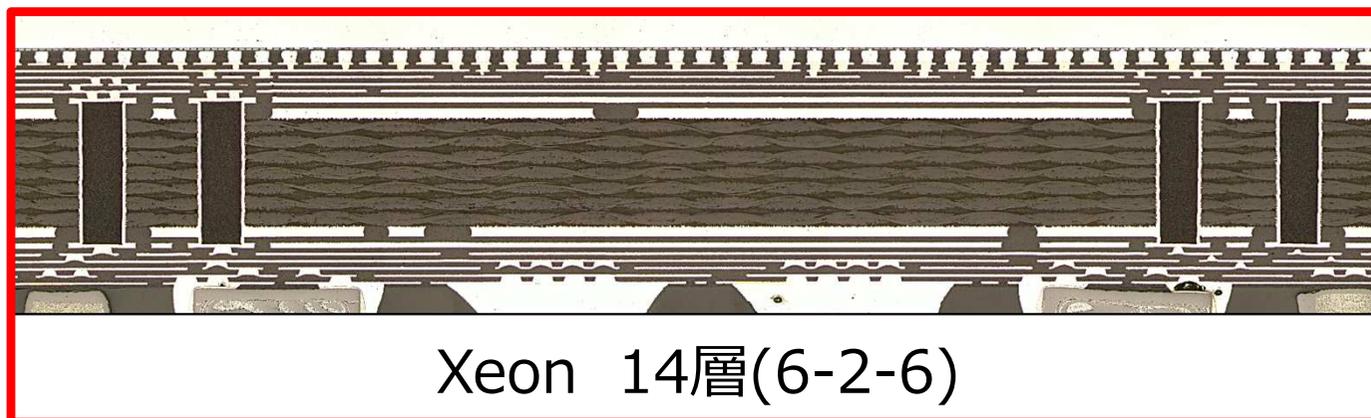
- **表面を処理し、化学的に密着性を向上**



# CZシリーズのロードマップ



# PKG基板の断面

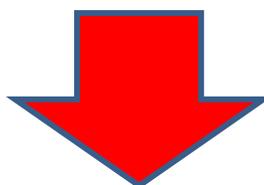
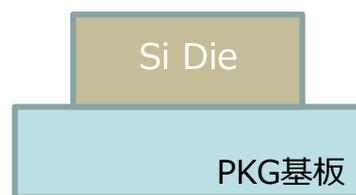


	PKG面積	層数
Xeon	27.44 cm <sup>2</sup>	14
Core i7	14.44 cm <sup>2</sup>	8
Ryzen	16.00 cm <sup>2</sup>	12

\*当社で入手、分解しました

通常のPKG

一つのPKGに  
一つの半導体



Chiplet

PKGを大きくし  
複数の半導体を搭載



EMIB

(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)



CoWoS

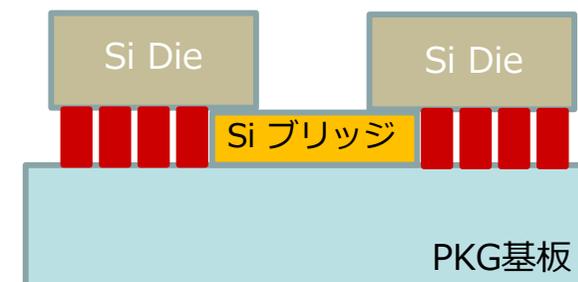
(Chip on Wafer on Substrate)



EFB

■ 銅ピラー

(Elevated Fanout Bridge)



PKG基板 ⇒ サイズ大型化、層数増加

メックグループ生産能力：8,100t/月（97,200 t /年）

\*北九州工場除く



尼崎工場（少量多品種）  
900 t /月



長岡工場（量産工場）  
2,750 t /月

稼働に向け計画進行中

新拠点



北九州工場（仮称）（量産工場）  
最大生産能力 2,500 t /月（予定）



メック台湾  
1,200 t /月



メック中国（蘇州）  
1,350 t /月



メック珠海  
1,000 t /月



メックヨーロッパ  
400 t /月



メックタイ  
500 t /月

2024年12月現在

# 界面価値創造

## Creating and Fostering Value at Various Interfaces

このプレゼンテーション資料には、2025年2月14日現在の将来に関する予測が含まれております。記述している将来予測および業績予測は、当社が現時点で入手できる情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知ください。

